公司代码:688535　　公司简称:华海诚科

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配方案为:公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至2025年4月22日,公司总股本为80,696,453股,扣除公司回购专用证券账户中股份数391,455股后的公司股本80,304,998股为基数,以此计算合计拟派发现金红利人民币16,060,999.60元(含税)。2024年半年度公司实施中期现金分红,以实施权益分派股权登记日的公司总股本80,696,453股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利8,069,645.30元(含税)。综上,2024年度公司现金分红(含中期分红)总额为24,130,644.9元(含税);本年度公司现金分红总额占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为60.23%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华海诚科	688535	/

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董东峰	钱云
联系地址	连云港经济技术开发区东方大道66号	连云港经济技术开发区东方大道66号
电话	0518-81066978	0518-81066978
传真	0518-82366016	0518-82366016
电子信箱	ir@hhck-em.com	ir@hhck-em.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1.主营业务

公司致力于半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售。是国内少数芯片级固体和液体封装材料研发量产的专业工厂。依托公司的核心技术体系,公司形成了可覆盖传统封装领域与先进封装领域的全面产品布局。

2.主营产品

公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂,广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。环氧塑封料(Epoxy Molding Compound,简称 EMC)全称为环氧树脂模塑料,是用于半导体封装的一种热固性化学材料,是由环氧树脂为基体树脂,以高性能酚醛树脂为固化剂,加入硅微粉等填料,以及添加多种助剂加工而成,主要功能为保护半导体芯片不受外界环境(水汽、温度、污染等)的影响,并实现导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。环氧塑封料应用于半导体封装工艺中的塑封环节,属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的产业环节。电子胶黏剂为半导体器件提供粘结、导电、导热、塑封等复合功能,可广泛应用于芯片粘结、芯片级塑封、板级组装等不同的封装环节,应用领域贯穿于一级封装、二级封装以及其他工业组装领域。

2.2主要经营模式

1.研发模式:公司的研发重点主要系半导体封装材料配方及生产工艺的开发与优化。在配方的开发过程中,公司需要结合不同封装形式对封装材料的性能要求及下游客户定制化需求,筛选出适合的原材料,确定各种物料的添加比例、添加顺序、混炼温度、混炼时间、混炼速度等生产工艺参数,从而在各理化性能指标的相互作用之间达到平衡,实现良好的综合性能。

2.采购模式:公司设置采购部、综合计划部等部门,根据公司生产需要,针对半导体封装材料生产所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购。公司综合计划部门负责物料需求的计划平衡和编制,按月、周编制物料需求计划;由采购部会同研发、工程、质检相关部门商定原辅材料询价及供应商选择事宜;由采购部会同制造部、技改部、设备部商定设备、备品备件询价及供应商选择事宜。采购部门根据原材料需求计划,综合考虑合格供应商的交期因素,在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单采购。

3.生产模式:公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式,以确保生产计划与销售情况相适应。公司拥有专业的生产管理团队,根据客户提出的各类要求及时做出响应,并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。

4.销售模式:公司坚持以客户为中心,以直接客户为主、贸易商客户为辅。公司已建立了一支营销能力强、经验丰富的专业销售团队,形成了以华东、西南与华南地区为主,其他区域为辅的销售布局。报告期内,公司现有经营模式取得了良好的效果,产品与技术布局持续完善,业务规模快速增长,公司经营模式未发生重大变化,在可预见的未来也不会发生重大变化。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 行业的发展阶段

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂,主要应用于半导体封装、板级组装。根据国家统计局《2017 年国民经济行业分类》(GB/T47542017),公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准,公司所处行业为半导体材料行业。

封装材料是电子封装技术中不可或缺的组成部分,对半导体产业起着至关重要的作用,并直接影响着智能终端等下游产品的发展。

近年来,随着高性能计算(HPC)、人工智能(AI)和 5G 通信等技术的需求日益增长,电子产品进一步朝向小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多。后摩尔时代,芯片物理性能接近极限,提高技术节点的经济效益有所放缓。半导体行业焦点从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移,WLCSP(晶圆级芯片规模封装)、FCCSP(倒装芯片级封装)、FCBGA(倒装芯片球栅阵列封装)、2.5D 封装、3D 封装、SiP(系统级封装)等先进封装技术的发展成为延续及超越摩尔定律、提升系统性能关键路径之一,先进封装技术的不断进步,对封装材料的要求也在不断提高,先进封装材料行业正迎来新的发展机遇,先进封装材料市场容量逐年增加,并有望持续增长。

1.2 基本特点

1.2.1 技术创新迭代速度快、门槛高。

一代封装一代材料。环氧塑封料的新产品开发需匹配下游封装技术持续提升的性能需求。公司研发、制造、销售的环氧塑封料与芯片级电子胶黏剂等封装材料是保证芯片功能稳定实现的关键材料,需要跟随下游封装形式的持续演进及客户的定制化需求而针对性地调整配方及生产工艺,又同时涉及高分子化学与物理、有机化学、无机非金属材料、电化学、表界面化学等多门学科的交叉,属于细分赛道产品,因此技术门槛较高。随着 Chiplet、HBM 等先进封装技术和工艺的不断发展,对于封装材料提出了更高的要求,各种先进封装技术对封装材料的性能需求不断提升,对公司的综合技术创新能力要求较高。

1.2.2 考核认证周期长,难进难出。

由于半导体封装材料对半导体器件的性能有显著影响,进而影响到终端产品的品质,因此一款新产品的批量供货,需要经过配方试制、客户的样品考核验证、批量验证后与客户达成正式合作。一个完整的新产品导入周期通常为 3 至 6 个月,长则可达 3 年以上。因此对封装材料厂商的技术与服务要求较高。鉴于公司产品的关键性,发行人与下游封装厂商达成业务合作后,在产品品质稳定和合理的性价比的情况下,下游厂商一般不会更换半导体封装材料供应商,双方合作通常具备长期稳定性。

1.3 主要技术门槛

1.3.1 配方体系复杂,需要在多项性能需求间实现有效平衡。

环氧塑封料的配方体系较为复杂。在配方开发过程中,公司需在众多化合物中筛选出数十种原材料(包括主料及添加剂)进行复配,确定合适的添加比例,并充分考虑成本等因素以满足量产的需求。由于配方中任一原材料的种类或比例变动都可能导致在优化某一性能指标时,对其它性能指标产生不利影响(例如,通过添加填料提升填充性的同时会使流动性下降),因此,产品配方需要充分考虑各原材料由于种类或比例不同对各项性能造成的相互影响,并在多项性能需求间实现有效平衡,以保证产品的可靠性。

1.3.2 环氧塑封料产品具有定制化的特点。

由于不同客户或同一客户不同产品的封装形式、生产设备选型、工艺控制、前道材料选用、可靠性考核要求及终端应用场景等方面存在差异,对环氧塑封料的各项性能指标都有独特的要求,公司下游封装厂商对环氧塑封料的需求呈现定制化特征。因此,公司需要通过针对性地优化与调整配方或生产工艺,对客户需求中所涉及的个性化技术难点进行攻坚,以满足客户针对工艺性能(如固化时间、流动性、冲丝、连续成模性、气孔率、分层、翘曲等)以及应用性能(如可靠性、热性能、电性能等)的定制化需求。

1.3.3 环氧塑封料的新产品开发需匹配下游封装技术持续提升的性能需求

由于历代封装技术及不同的应用领域对环氧塑封料的性能要求均存在差异,环氧塑封料厂商需以下游技术的发展为导向,持续开发在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面与历代封装技术相匹配的新产品,故而业内呈现出“一代封装,一代材料”的特点。封装技术的持续演进对环氧塑封料提出了更多、更严苛的性能要求。其中,先进封装中的 QFN/BGA、FOWLP/FOPLP 等因其不对称封装形式而增加了对环氧塑封料的翘曲控制要求,同时要求环氧塑封料在经过更严苛的可靠性考核后仍不出现任何分层且保持芯片的电性能良好。因此,公司在应用于先进封装产品的配方开发中需要在各性能指标间进行更为复杂的平衡(例如,需要进一步考虑 Tg、CTE 与应力间的相互影响以实现翘曲控制),对塑封料厂商的自主创新能力与技术储备要求进一步提升,产品开发难度进一步加大。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

自 2010 年成立以来,公司始终专注于半导体封装材料的研发及产业化,10 余年来公司深耕于半导体封装材料的研发创新,核心技术以配方技术与生产工艺技术作为体系基础,可广泛应用于传统封装与先进封装领域,技术储备丰富且具有前沿性,可为客户解决历代下游主流封装技术的需求难点提供有力的技术支撑,公司拥有独立自主的系统化知识产权。公司是国家高新技术企业,被工信部认定为专精特新“小巨人”企业。公司紧跟下游封装行业的发展趋势,以客户需求为导向,对相关技术难点进行持续攻坚,形成适合各类封装形式的全系列产品与技术布局。在传统封装领域,公司产品结构全面并已实现产业化,市场份额逐步扩大,在国内市场已具备较高的品牌知名度及市场影响力;在先进封装领域,公司相关产品已陆续通过客户考核验证,技术水平取得业内主要封装厂商的认可,公司在加大核心技术开发的同时,注重在半导体封装材料领域的研发成果的运用,注重实现核心技术的产业化。依托公司具有市场竞争优势的核心技术体系,公司专注于向客户提供更有竞争力的环氧塑封料与电子胶黏剂产品,构建可应用于传统封装(包括 DIP、TO、SOT、SOP 等)与先进封装(QFN/BGA、SiP、FC、FOWLP 等)的全面产品体系,可满足下游客户日益提升的性能需求。凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务,公司已与长电科技、通富微电、华天科技、银河微电、扬杰科技等业内领先及主要企业建立稳固的合作伙伴关系,业务规模持续扩大,有序实现研发技术的产业化落地,推动经营业绩的快速提升。公司与业内主流封装厂商均已建立长期稳定的合作关系。未来,随着上述厂商新增产能的逐渐落地,公司作为内资环氧塑封料代表性厂商之一,将凭借自身的研发、产品、服务、口碑等优势进一步提升市场份额。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

我国集成电路产业的快速发展,为封装测试行业的发展提供强劲动力,国内三家封测龙头企业均已进入全球封测业十强,且仍在继续扩张中。目前封装测试产业已经成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节,有望率先实现国产替代。随着我国封测产业规模不断扩大,在国家鼓励半导体材料国产化政策的影响下,给国内半导体材料企业带来发展机遇。

先进封装占比将逐步超越传统封装,先进封装材料成为主流。随着电子产品进一步朝小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出/入脚数大幅增加,使得倒装焊、圆片级、系统级、扇出型、2.5D/3D、Chiplet 等先进封装技术成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升。从下游需求来看,近年新能源汽车的销量出现了爆发式的增长,同时电动化、智能化已经成为汽车行业发展的必然趋势,汽车上的电子电器装置数量的急剧增多,对用于汽车电子的塑封料和胶黏剂有更多的需求。由于车规级器件在生产、管控及测试环节都经历更为严格的标准和要求,以确保其能在汽车环境中稳定运行,因此车规级比工业级用塑封料和胶黏剂要求更严格。AI 浪潮对于先进封装的发展起到关键作用。目前全球绝大部分 AI 芯片厂商均采用了 Chiplet 先进封装,台积电 Cowos 产能持续吃紧。2023年,全球先进封装市场迎来一次小“滑坡”,规模达到378亿美元,同比下降3.8%。这主要是因为半导体行业周期性调整。从2024年开始,先进封装市场逐渐复苏,预计2023-2029年的复合年增长率(CAGR)能达到11%,到2029年市场规模将突破695亿美元。对比传统封装(CAGR 4%),先进封装的市场份额将从2023年的44%提升至2029年的50%,成为半导体封装增长的核心驱动力,也将带动高端半导体材料需求持续成长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,402,647,705.52	1,230,461,176.67	13.99	505,706,651.89
归属于上市公司股东的净资产	1,039,069,276.16	1,027,268,796.58	1.15	378,831,238.88
营业收入	331,634,930.76	282,902,181.17	17.23	303,224,299.77
归属于上市公司股东的净利润	40,063,058.84	31,638,634.12	26.63	41,226,772.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,132,299.37	27,396,679.83	24.59	35,183,502.44
经营活动产生的现金流量净额	2,976,498.49	31,605,240.29	-90.58	11,953,253.94
加权平均净资产收益率(%)	3.89	3.68	增加0.21个百分点	11.43
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05	0.68
研发投入占营业收入的比例(%)	7.96	8.71	减少0.75个百分点	6.03

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	72,402,604.63	82,916,867.33	84,328,274.77	91,987,184.03
归属于上市公司股东的净利润	12,771,702.45	12,122,694.95	10,022,302.73	5,146,358.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,856,353.88	10,909,093.37	9,897,032.80	469,819.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,243,303.78	3,561,360.16	4,453,403.23	-1,794,961.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,488
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,289
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
韩江龙	0	11,241,799	13.93	11,241,799	无	0	境内自然人
连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)	0	10,308,091	12.77	10,308,091	无	0	其他
杨森茂	0	5,390,171	6.68	0	无	0	境内自然人
陶军	0	3,459,500	4.29	3,459,500	无	0	境内自然人
天水华天科技股份有限公司	0	3,257,576	4.04	0	无	0	境内非国有法人
成兴明	0	3,231,515	4.00	3,231,515	无	0	境内自然人
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	0	2,420,801	3.00	0	无	0	其他
中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司-聚源信诚(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	-466,592	1,329,408	1.65	0	无	0	其他
李启明	0	1,177,273	1.46	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	1,140,297	1,141,904	1.42	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司董事陶军为连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。(2)韩江龙、成兴明、陶军三人通过连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)控制的表决权比例为12.77%,且上述三人签订了《一致行动人协议》,因此韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。(3)除上述情况外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

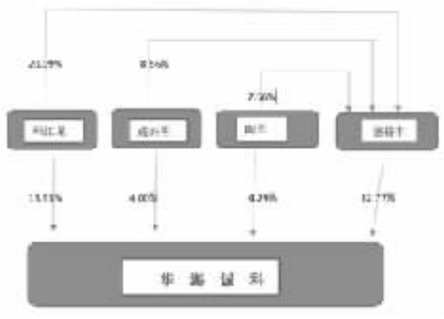
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入33,163.49万元,同比增长17.23%;归属于上市公司股东的净利润4,006.31万元,同比增长26.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,413.23万元,同比增长24.59%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688535　　证券简称:华海诚科　　公告编号:2025-027

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行的变更和调整,符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称“解释17号”),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”的相关内容,根据前述文件要求,本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。

财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号,以下简称“解释18号”),规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容,根据前述文件要求,本公司自2024年12月6日起执行解释18号的相关规定。

(二)变更前公司实施的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后公司实施的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行的变更和调整,符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况,无需提交公司董事会和股东大会审议。执行解释17号中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定和执行解释18号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定对公司本报告期内以及可比期间财务数据无影响。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:688535　　证券简称:华海诚科　　公告编号:2025-024

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开公司第三届董事会第二十四次会议,审议了《关于公司2025年度董事薪酬与考核方案的议案》,审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》;于2025年4月22日召开第三届监事会第二十二次会议,审议了《关于公司2025年度监事薪酬与考核方案的议案》。其中,《关于公司2025年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和监事回避表决,直接提交公司股东大会审议;《关于公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决,其余出席会议的3名董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》等有关规定,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,具体情况公告如下:

一、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

(二)适用日期

2025年1月1日至2025年12月31日

(三)组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

(四)薪酬标准

1、公司董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴标准为每年8万元(税前)。公司非独立董事在公司及控股子公司担任职务的董事,将根据其担任的具体职务,综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平确定其薪酬(薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等);公司外部董事不在公司领取薪酬。

2、监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

3、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

(五)其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,根据其实际任期按此方案计算并予以发放;

3、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

4、公司2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:688535　　证券简称:华海诚科　　公告编号:2025-025

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定,江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)86号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,018万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币35.00元,募集资金总额为人民币706,300,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币73,361,785.82元后,实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。

上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年3月31日出具《验资报告》(中汇会验[2023]2314号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金40,401.90万元,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为24,588.02万元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	655,922,000.00
减:支付其他发行费用	17,546,986.28
减:置换预先支付的发行费用	5,278,525.01
减:置换预先投入募集项目资金	32,395,936.27
减:直接投入募集项目资金	69,861,833.16
减:超募资金对外投资	301,761,201.53
加:利息收入扣除手续费净额	16,802,719.56
截至2024年12月31日募集资金余额	245,880,237.31
其中:存放募集资金专户余额	5,880,237.31
募集资金现金管理余额	240,000,000.00

注1:截至2024年12月31日,与发行权益性证券相关的印花税158,274.12元尚未支付

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定,制定了《募集资金管理制度》。

公司已于2023年3月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	账户类别
上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801200003208	1,181,324.69	募集资金专户
招商银行股份有限公司连云港分行营业部	518900004910888	12,017.75	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司连云港分行	638293365	12,116.78	募集资金专户
交通银行股份有限公司连云港科技支行	327060612013000215847	4,674,732.94	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司连云港分行	57360180803999505	45.15	募集资金专户
合计		5,880,237.31	

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

公司于2024年4月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币57,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品),使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。在上述额度范围和使用期限内,公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。

截至2024年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币元

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	30,000,000.00	2023-5-5	2026-5-5	3.15%
2	中国民生银行股份有限公司连云港分行	对公大额存单	保本固定收益型	60,000,000.00	2023-4-28	2026-4-28	3.30%
3	交通银行股份有限公司连云港科技支行	企业大额存单	保本固定收益型	150,000,000.00	2023-5-4	2026-5-4	3.20%
合计				240,000,000.00	-	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024年11月13日,本公司召开第三届董事会第十九次及第三届监事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案》,使用全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金合计48,000.00万元认购衡所华威电子有限公司30%股权,2024年11月29日,公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过上述议案,具体内容详见公司于2024年11月15日以及于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》(公告编号:2024-045)及《江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-058)。截至2024年12月31日,本公司使用超募资金及其收益支付上述股权转让对价共计301,761,201.53元。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年8月20日,公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,为加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司将根据实际需要以承兑汇票方式支付募投项目所涉款项(如应付设备采购款、应付工程款、材料采购款以及其他相关所需资金等),再以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2024年8月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-024)。2024年度,公司共计置换募集资金331.78万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年8月20日,第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》,同意根据公司研发中心提升项目的研发进度,为充分发挥公司竞争优势,提高募集资金使用效率及效益,对募投项目的实施方式和内部投资结构进行调整。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2024